

## Descrizione del prodotto

FINITURA: QUESTA SCHEDA DEVE ESSERE IMMERSIONE ORO PLACCATO SECONDO IPC-6012.  
SPESSORE deve essere .050uM sopra 3-6uM nichelatura.

PIASTRA DI RAME FORI MINIMO.025 MEDIO,.020 MIN... FORI NON POSSONO ESSERE COLLEGATI

Pack con film a bolle trasparente incolore, 25 pz V borsa, mettere essiccante nel fianco, mettere carta indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura a strati

L1---HOZ

-7mil PP-

--

L2---1OZ

-CORE 9.05mil-

L3---1OZ

--

-7mil PP-

L4---HOZ

Definizioni di layer:

\*. GCMT - maschera superiore Conformal Coating

\*. GTP - pasta saldante superiore

\*. GTO - Top Silkscreen

\*. GTS - Top Soldermask

\*. GTL - strato superiore

-----

\*. G2L - strato interno segnale 1

=====

\*. G3L - segnale interno Layer 2

-----

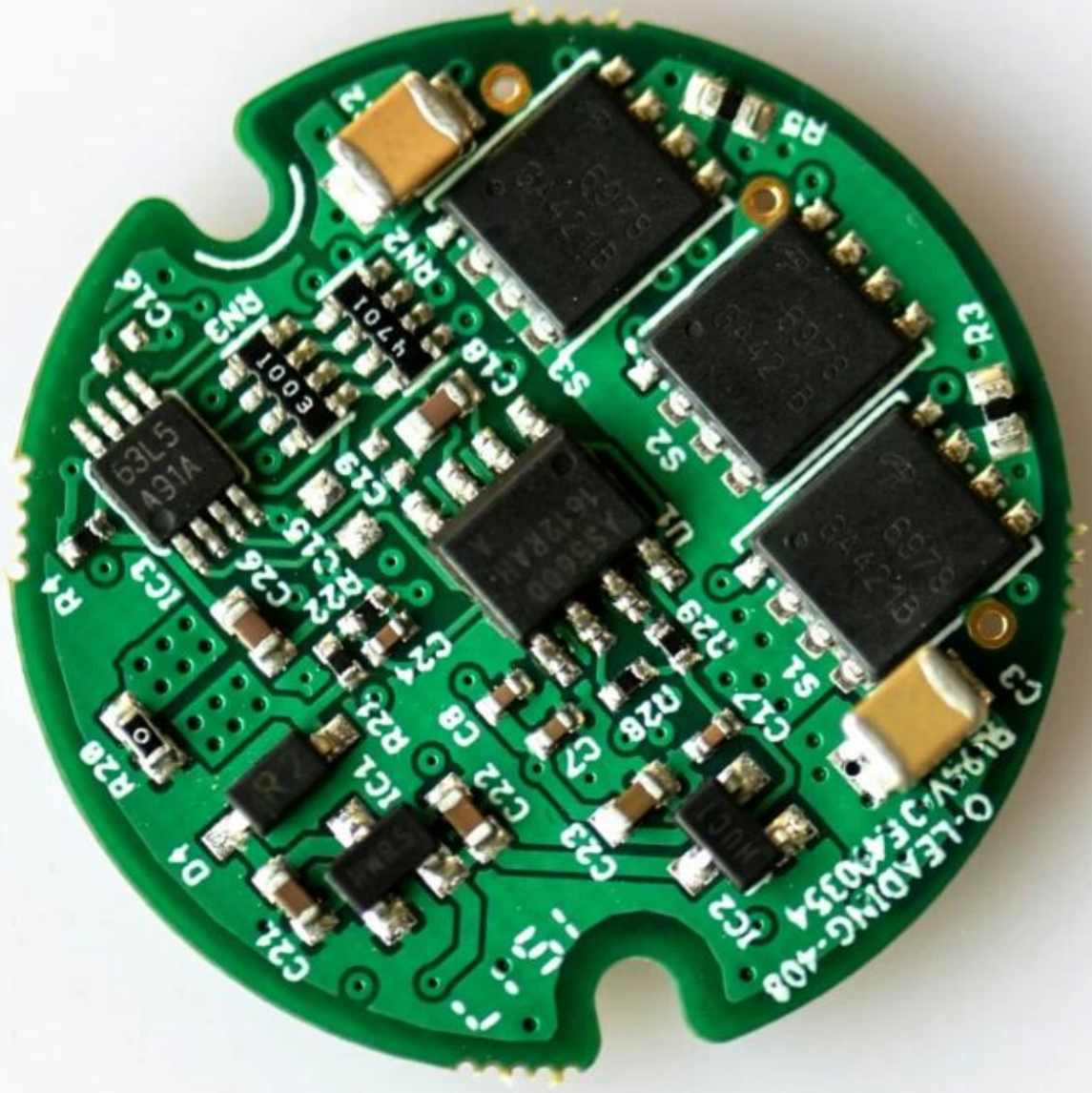
\*. GBL - strato inferiore

\*. GBS - Bottom Soldermask

\*. GBO - fondo Silkscreen

\*. GBP - pasta saldante inferiore

\*. GCMB - fondo Conformal Coating maschera



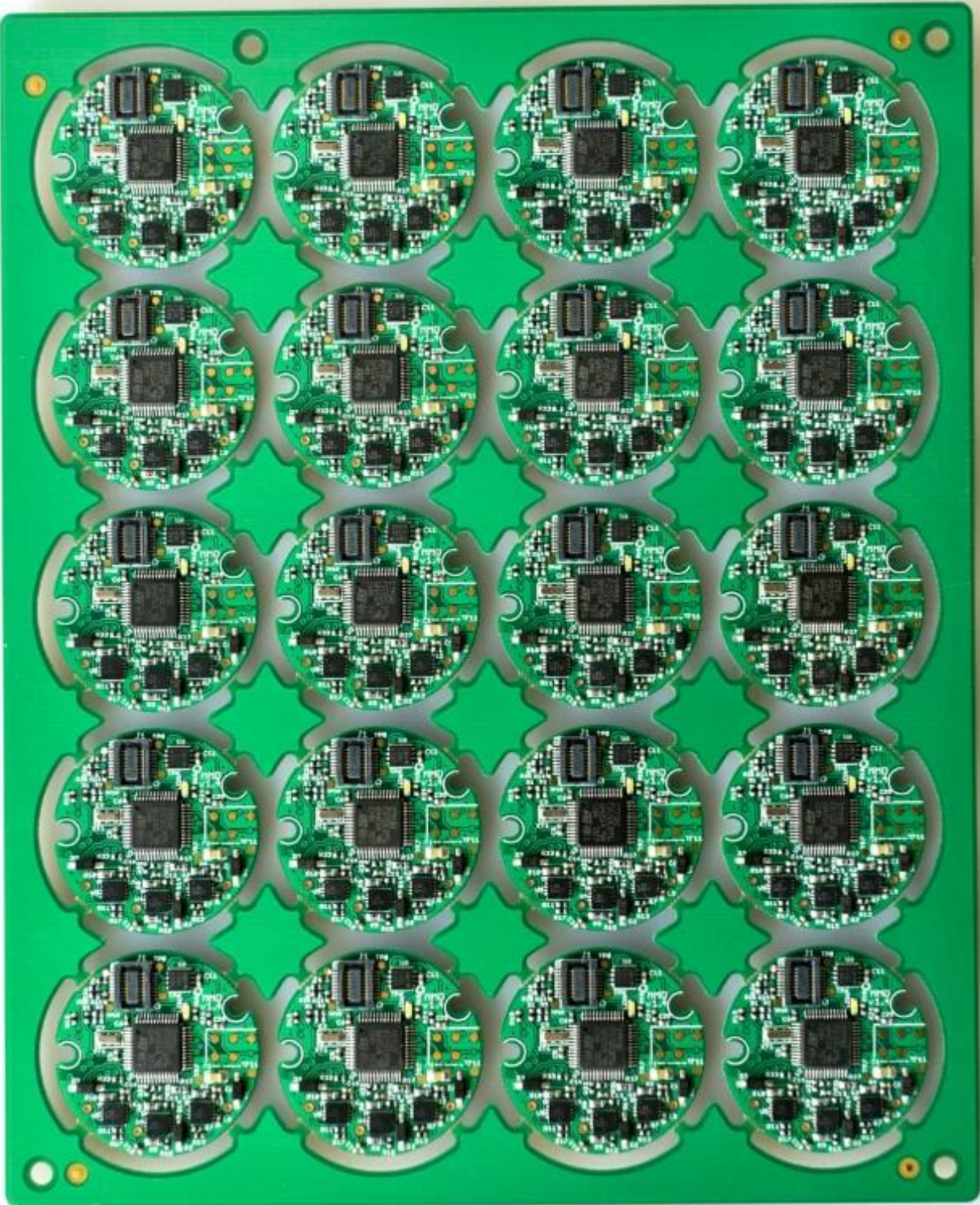
O-LEADING-408  
R19/V3/E4/0354  
C2

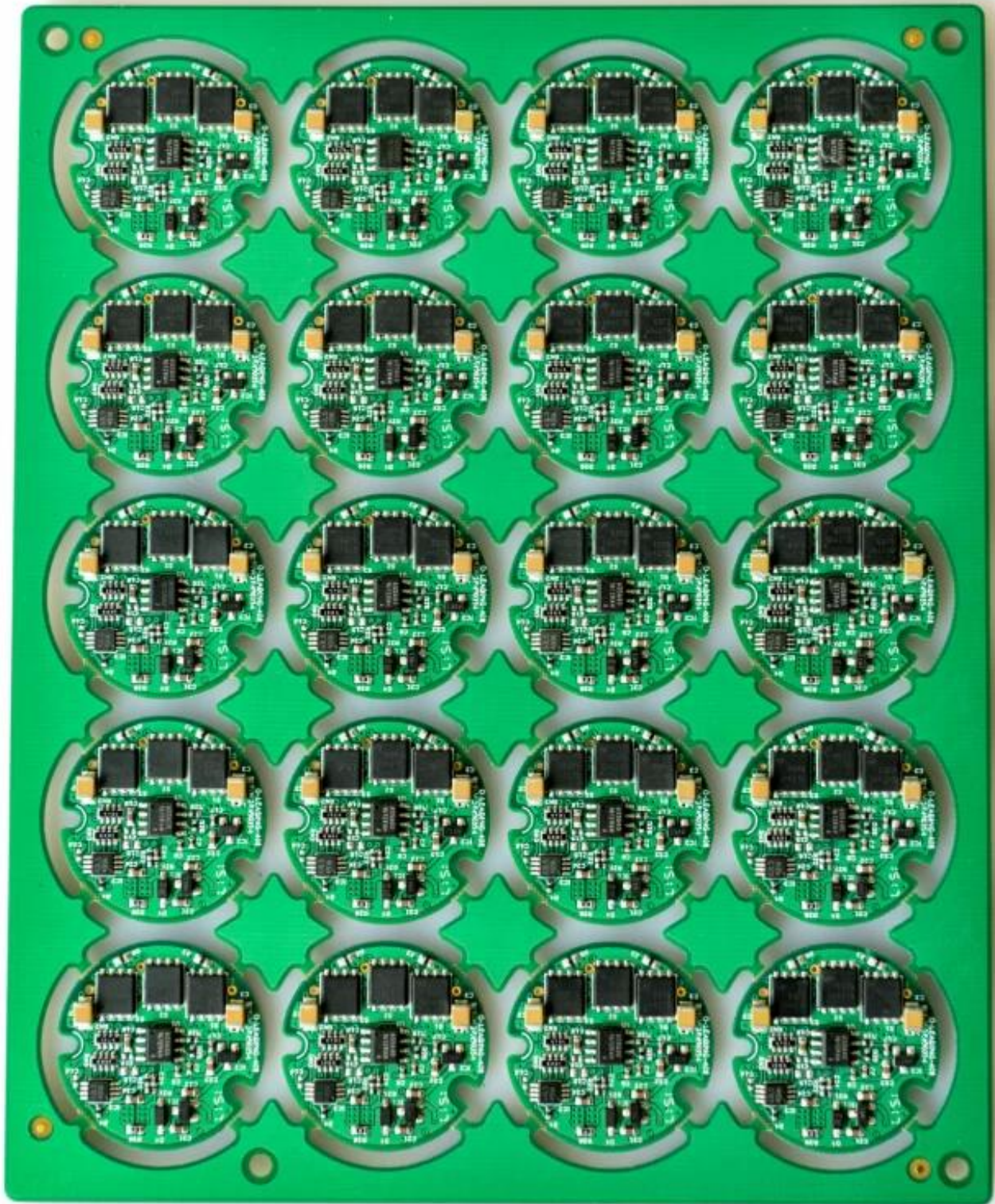
6315  
191A

1003

5701







[PCB Produttore in Cina, azienda del circuito stampato](#)